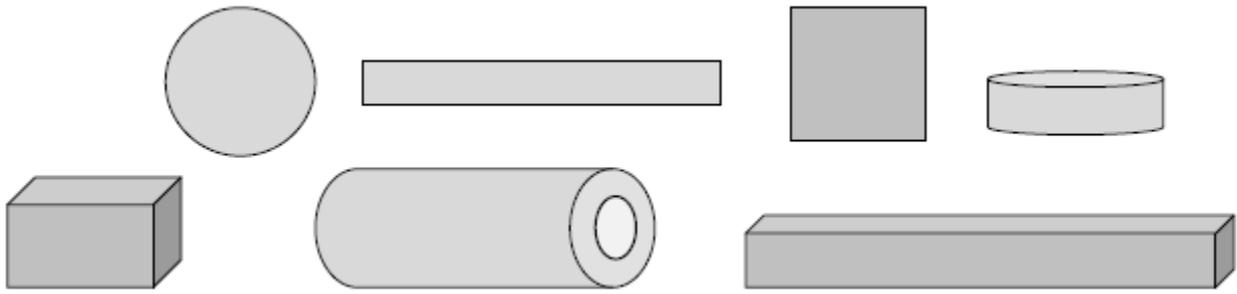


Установочная керамика



Установочная керамика предназначена для изготовления плат микромодулей, подложек для микросхем, непроволочных резисторов, высоковольтных и подстроечных конденсаторов, изоляторов и других установочных деталей.

Основные кристаллические фазы:

- кордиерит
- форстерит
- перовскит
- корунд
- цельзиан
- шпинель

Основные характеристики:

- диэлектрическая проницаемость: $\epsilon = 4,5...10,5$
- электрическая прочность: $E_{пр} \geq 25$ МВ/м
- тангенс угла диэлектрических потерь: $tg\delta \leq 2 \times 10^{-4}$ ($f = 1$ МГц)
- предел прочности при статическом изгибе: $\delta_{изг} = 78...147$ МПа
- температурный коэффициент линейного расширения: $\alpha = 2...12$ МК⁻¹ (20...100 °С)
- микропористость: 2...5 %
- размер пор: до 5 мкм
- температура спекания в воздушной среде: 1250...1700 °С

